

Intel est prêt pour le 32 nm

Intel a achevé sa phase de développement et de test pour le procédé de gravure en **32 nm**. En passant de la technologie 45 nm au 32 nm, la firme prévoit d'augmenter la densité de ses puces, ce qui permettra **de monter en fréquence et de diminuer la consommation**.

Autre effet intéressant, le coût de fabrication des processeurs actuels sera réduit, puisqu'ils occuperont moins de place sur le *wafer*. La mise en production des premiers composants est prévue pour le **quatrième trimestre 2009**.

Cette année, Intel a lancé ses processeurs Atom et Core i7. Ses nouvelles architectures profiteront du 32 nm. La stratégie de la compagnie est simple : elle utilisera le 32 nm sur les architectures existantes, puis – un an plus tard – en lancera de nouvelles. Encore un an plus tard, ces nouvelles architectures basculeront en 22 nm, et ainsi de suite. C'est ce qu'Intel appelle le « *tic-toc* » (une année est dédiée au changement d'architecture et la suivante au changement de finesse de gravure).

Pour **Mark Bohr**, Intel senior fellow et directeur de la division process architecture & integration d'Intel : « *cette nouvelle prouesse dans les techniques de fabrication et les produits pour les micro-ordinateurs et les serveurs qui en résulteront confortent notre avance dans les performances informatiques, le rendement électrique et, dans le cas des PC portables, dans l'autonomie sur batterie. Comme nous l'avons démontré cette année, notre stratégie de production nous a également permis de proposer des lignes de produits entièrement nouvelles pour les PC de poche, l'électronique grand public, l'informatique embarquée et les netbooks.* »

La compagnie conserve ainsi son avance dans le domaine de la course aux nanomètres, au grand dam d'AMD qui migre doucement du 65 nm vers le 45 nm. Le fondeur commence même à étudier **le passage au 22 nm**.